

埋阻高频覆铜板

睿龙埋阻高频覆铜板电阻层加工指南

一、制作埋平面电阻图形工艺流程:

下料→一次覆膜→曝光、显影→检查→一次蚀刻(蚀刻铜)→二次蚀刻(蚀电阻层)→褪膜 →清洗→二次覆膜→曝光、显影→检查→三次蚀刻(蚀刻铜)→清洗检查→褪膜→测量电阻 →清洗→目检→层压

二、关键控制点一三次蚀刻:

采用水平式碱性氯化铜蚀刻液,

温度: 48-54℃,

PH值: 7.6-8.4,

含铜量: 1.17-1.19 g/L,

喷淋压力: 18-22 PSI。

三、以下是蚀刻处理时的一些需要注意事项:

- 1) 电阻层在蚀刻液中会被慢慢蚀刻,所以在蚀刻液里的时间越长,电阻值偏离就越大, 其误差就越大,该误差可以通过改变蚀刻图形来补偿;
- 2)如果待处理板上只有一面有电阻,蚀刻时电阻面应朝下,以免蚀刻液聚集在电阻面上;
- 3) 批量生产前,应做试板以优化蚀刻条件;
- 4) 不要触摸、弯折和刮伤曝露的电阻层。